



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109524577 A

(43)申请公布日 2019.03.26

(21)申请号 201811529882.5

(22)申请日 2018.12.14

(71)申请人 湖畔光电科技(江苏)有限公司

地址 213200 江苏省常州市金坛市金坛区
华城中路168号

(72)发明人 邹成 刘志文

(74)专利代理机构 北京律远专利代理事务所
(普通合伙) 11574

代理人 全成哲

(51)Int.Cl.

H01L 51/56(2006.01)

H01L 51/52(2006.01)

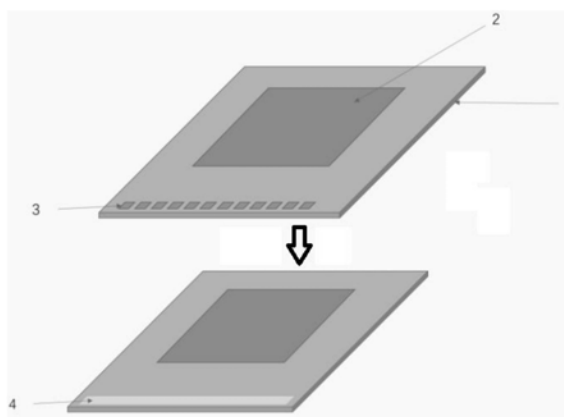
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种有机发光显示器接口保护方法

(57)摘要

本发明公开了一种有机发光显示器接口保护方法,其在有机显示芯片清洗后,进行有机蒸镀等后续工艺之前,通过贴附的方式在电气接口处贴附UV膜并保证UV膜完全覆盖电气接口,在做完所有蒸镀封装等工艺后,通过UV照射使UV膜固化以降低UV膜与芯片的粘附力,再揭下UV膜即可。本发明的有机发光显示器接口保护方法简单有效,且成本低,不仅可以有效的保护电气接口不受污染,而且可以去除后续所有工艺造成的污染。



1. 一种有机发光显示器接口保护方法,其特征在于:在有机显示芯片清洗后,进行有机蒸镀等后续工艺之前,通过贴附的方式在电气接口处贴附UV膜并保证UV膜完全覆盖电气接口,在做完所有蒸镀封装等工艺后,通过UV照射使UV膜固化以降低UV膜与芯片的粘附力,再揭下UV膜即可。

2. 根据权利要求1所述的有机发光显示器接口保护方法,其特征在于:贴附的方式为机械贴附。

3. 根据权利要求1所述的有机发光显示器接口保护方法,其特征在于:所述UV膜沿所述电气接口周侧外沿延伸覆盖至少0.2mm。

4. 根据权利要求1所述的有机发光显示器接口保护方法,其特征在于:所述UV膜沿所述电气接口周侧外沿延伸覆盖0.5mm。

5. 根据权利要求1所述的有机发光显示器接口保护方法,其特征在于:通过机械方式揭下UV膜。

一种有机发光显示器接口保护方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种有机发光显示器接口保护方法。

背景技术

[0002] 在微电子领域,器件和材料表面的清洗一直是科学研究的一个重要环节,随着现代科学技术的发展,电子器件的尺度和精密机械的配合间隙越来越小,微米级颗粒的污染也会带来很大危害。在半导体芯片封装工艺中,半导体芯片交接贴砖在印刷线路板上,芯片与基板的电气连接用引线键合的方法实现,并用树脂覆盖以确保可靠性。芯片与基板建立电气连接的部位即为接口。有机发光显示器在制造过程中,显示器接口部位会受到污染,即使只是沾染到微米粒级的颗粒污染物也会对后续的压线工艺造成很大的障碍,影响电气连接的资料,并且直接影响到有机发光显示器的产品合格率,造成产品成本增大。

[0003] 传统的机械摩擦清洗、化学腐蚀清洗、高频超声清洗、激光清洗等清洗方式,要么就会产生研磨、热效应,要么就设备成本很高。

发明内容

[0004] 为了解决上述技术问题,本发明的目的是提供一种有机发光显示器接口保护方法,该方法简单有效,且成本低。

[0005] 为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:

[0006] 一种有机发光显示器接口保护方法,在有机显示芯片清洗后,进行有机蒸镀等后续工艺之前,通过贴附的方式在电气接口处贴附UV膜并保证UV膜完全覆盖电气接口,在做完所有蒸镀封装等工艺后,通过UV照射使UV膜固化以降低UV膜与芯片的粘附力,再通过机械方式揭下UV膜即可。

[0007] 进一步的,贴附的方式为机械贴附。

[0008] 进一步的,所述UV膜沿所述电气接口周侧外沿延伸覆盖至少0.2mm。

[0009] 进一步的,所述UV膜沿所述电气接口周侧外沿延伸覆盖0.5mm。

[0010] 进一步的,通过机械方式揭下UV膜。

[0011] 与现有技术相比,本发明的有益技术效果:

[0012] 本发明的方法简单,实用性极强,不仅可以有效的保护电气接口不受污染,而且可以去除后续所有工艺造成的污染。

附图说明

[0013] 下面结合附图说明对本发明作进一步说明。

[0014] 图1为有机发光显示器接口的贴附示意图;

[0015] 附图标记说明:1-有机显示器;2-显示区域;3-电气接口;4-UV膜。

具体实施方式

[0016] 一种有机发光显示器接口保护方法,芯片清洗后如图1所示,在电气接口3机械贴附一层UV膜4,然后在进行完薄膜封装工艺和玻璃盖板封装工艺后,在UV膜4附近用UV光进行照射,使UV膜固化以降低UV膜与芯片的粘附力,最后将贴附在电气接口处的UV膜4揭掉,最终裸露出电气接口3即可。

[0017] 本发明的方法简单,可操作性强,实用性佳,可以有效的保护电气接口不受污染,可以去除后续所有工艺造成的污染。

[0018] 以上所述的实施例仅是对本发明的优选方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。

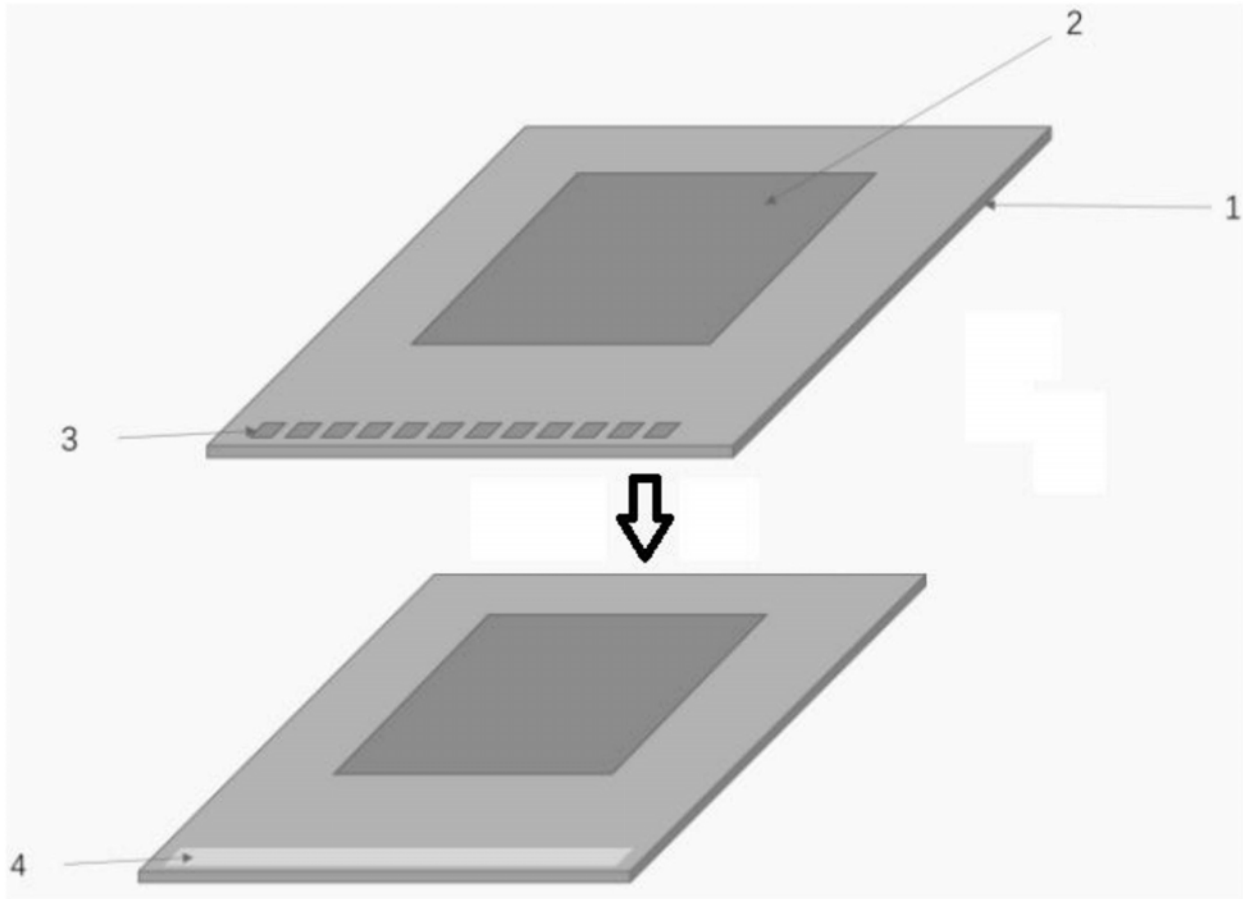


图1

专利名称(译)	一种有机发光显示器接口保护方法		
公开(公告)号	CN109524577A	公开(公告)日	2019-03-26
申请号	CN201811529882.5	申请日	2018-12-14
[标]发明人	邹成 刘志文		
发明人	邹成 刘志文		
IPC分类号	H01L51/56 H01L51/52		
CPC分类号	H01L51/5253 H01L51/56		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明公开了一种有机发光显示器接口保护方法，其在有机显示芯片清洗后，进行有机蒸镀等后续工艺之前，通过贴附的方式在电气接口处贴附UV膜并保证UV膜完全覆盖电气接口，在做完所有蒸镀封装等工艺后，通过UV照射使UV膜固化以降低UV膜与芯片的粘附力，再揭下UV膜即可。本发明的有机发光显示器接口保护方法简单有效，且成本低，不仅可以有效的保护电气接口不受污染，而且可以去除后续所有工艺造成的污染。

